(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-295520

(43)公開日 平成8年(1996)11月12日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C03B 8/0	l		C 0 3 B	8/04		
20/0	)			20/00		
C 0 3 C 3/0	3		C 0 3 C	3/06		
H01S 3/0			H01S	3/08		Z
			審査請才	え 未請求	請求項の数 9	FD (全 8 頁)
(21)出願番号	特願平7-123085		(71)出顧人	3900050	390005072	
				日本石	英硝子株式会社	
(22)出願日	平成7年(1995)4月24日			東京都	品川区東大井二	丁目13番8号
			(72)発明者	葛生	伸	
				千葉県	松戸市久保平賀2	774番地の1 ラミ
				ーユ松	戸ハイライズ1-	-501

(54) 【発明の名称】 光学用合成石英ガラス及び吸収帯の生成防止方法

### (57)【要約】

【目的】 高パルス数(10<sup>6</sup>ショット以上)のエキシマレーザー照射や、誘電体パリア放電エキシマランプのように連続的に長時間(連続数百時間)にわたり照射しても、吸収帯の生成のない安定した光学用合成石英ガラス及び吸収帯の生成を防止する方法を提供する。

【構成】 四塩化珪素を酸水素火炎中で加水分解し、直接堆積ガラス化してなる合成石英ガラスにおいて、酸水素火炎の水素と酸素の比がモル比で2.2以上の条件下で合成し、かつ〇H基を1150ppm以上含有してなる光学用合成石英ガラス及びエネルギー線長時間照射による吸収帯の生成を防止する方法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 四塩化珪素を酸水素火炎中で加水分解 し、直接堆積ガラス化してなる合成石英ガラスにおい て、酸水素火炎の水素と酸素の比がモル比で2.2以上 の条件下で合成し、かつOH基を1150ppm以上含 有してなる光学用合成石英ガラス。

【請求項2】 石英ガラス中のOH基濃度を1150p pm以上とし、かつ、酸・水素火炎の水素と酸素の比が モル比で2. 2よりも過剰の水素の存在下で合成するこ とによって、エネルギー線長時間照射による吸収帯の生 10 成を防止する方法。

【請求項3】 吸収帯がE'センターによる220nm 付近にピークをもつものである請求項2記載の吸収帯の 生成を防止する方法。

【請求項4】 吸収帯が260nm付近にピークをもつ ものである請求項2記載の吸収帯の生成を防止する方 法。

【請求項5】 エネルギー線が電磁波である請求項2記 載の吸収帯生成を防止する方法。

【請求項6】 電磁波が紫外線である請求項5記載の吸 20 収帯生成を防止する方法。

【請求項7】 紫外線がエキシマレーザーおよび/また はエキシマランプである請求項6記載の吸収帯を防止す る方法。

【請求項8】 エキシマレーザーがArFエキシマレー ザーおよび/またはKFFエキシマレーザーである請求 項7記載の吸収帯生成を防止する方法。

【請求項9】 エキシマランプがKrC1および/また はXe<sub>2</sub>である請求項7記載の吸収帯生成防止方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、合成石英ガラス、特 に、紫外領域、例えば、エキシマレーザーなどに使用さ れる光学部品、超LSI用フォトマスク基板、超LSI ステッパー用光学材料、誘電体バリア放電エキシマラン プ管材等に使用される特に連続的に長時間にわたり(エ キシマレーザー:10゚ショット以上、エキシマラン プ:連続数百時間) 照射しても、吸収帯の生成のない安 定した光学用合成石英ガラス及び吸収帯の生成を防止す る方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エキシマレーザーを用いた超LSI製造 プロセスやCVDプロセスなどが発展し、エキシマレー ザー用光学材料に対する要求が特に高まっているが、近 年、誘電体パリア放電エキシマランプが開発され、エキ シマレーザーと比較して手頃な遠紫外線光源として注目 されている。

【0003】エキシマレーザーは、希ガスとハロゲン、 あるいは希ガス、ハロゲン単体を用いたガスレーザー

nm)、XeClエキシマレーザー(308nm)、K rFエキシマレーザー (248nm)、KrClエキシ マレーザー (220 nm)、ArFエキシマレーザー (193nm)、F2エキシマレーザー(157nm) などがある。

【0004】また、誘電体パリア放電エキシマランプ は、エキシマレーザー用と同様のガスを封じ込んだ石英 ガラス管を挟んで高電圧を印加することにより発光を得 るランプで、X e₂ (1 7 2 n m) 、K r C l (2 2 0 nm)、XeC/ (308nm) などが市販されてい

【0005】エキシマレーザーのうち、発振効率とガス 寿命の点からXeClエキシマレーザー、KrFエキシ マレーザー、ArFエキシマレーザーが有利である。さ らに、半導体素子の製造工程で用いられる光源として は、KrFエキシマレーザーおよび、ArFエキシマレ ーザーが注目されている。

【0006】ArFエキシマレーザーや、KrFエキシ マレーザーは、従来の水銀ランプなどの輝線を用いた光 源と比較すると、波長が短く、エネルギー密度がはるか に高いため、ステッパーなどの石英ガラス製の光学部品 に対して損傷を与える可能性が大きい。事実、合成石英 ガラスにエキシマレーザーを照射したり、合成石英ガラ ス製フォトマスク基板にプラズマエッチングやスパッタ リングを実施すると、吸収帯が形成され、その結果とし て発光が発生したりするという欠点を有していた。

【0007】また、誘電体パリア放電エキシマランプに おいても、そのパワーは低いものの連続的に長時間使用 するため、そのランプ管や窓材に使用した場合、吸収帯 30 が形成され、その結果として発光が発生するという同様 の問題が生ずる。

【0008】このような合成石英ガラスフォトマスク基 板がプラズマエッチングやスパッタリングを受けて吸収 帯を形成するような石英ガラスを予め判別する方法とし て、合成石英ガラスにエキシマレーザーを照射し、赤色 の発光が生じるか否かによって、有害な吸収帯が形成さ れるか否かを判別する方法(特開平1-189654号 公報:合成石英ガラスの検査方法)が開示されている。

【0009】また、特開平1-201664号公報(合 40 成石英ガラスの改質方法)には、四塩化珪素を化学量論 的比率の酸水素火炎中で加水分解して得られた合成石英 ガラスを水素ガス雰囲気中で熱処理することによっても 赤色発光のない合成石英ガラスに改質できることが開示 されている。

【0010】さらに、特開平2-64645号公報(紫 外域用有水合成石英ガラス及びその製法)には、四塩化 珪素を酸水素火炎で加水分解する際、パーナーに供給す る酸水素火炎の水素ガスと酸素ガスの比(H2/O2)を 化学量論的必要量比よりも大きくする、すなわち、水素 で、ガスの種類によりXeFエキシマレーザー(3 5 0 の量を化学量論的必要量より過剰の還元雰囲気にするこ

とにより、260nmの吸収帯の生成およびそれに伴う 合成石英ガラスの650nmの赤色発光を防止できるこ とが示されており、同時に、この製法によって得られた 合成石英ガラスは、200nmでの透過率が低下するの で、これを防止するため、四塩化珪素に同伴ガスとし て、不活性ガスを使用することが開示されている。

【0011】このように、還元雰囲気下で合成した合成 石英ガラスは、KrFエキシマレーザーに対しては、耐 久性を有するが、より短波長のエキシマレーザーである ArFエキシマレーザーを照射すると220nm付近に 10 する。 ピークを有する吸収帯が生じ、エキシマレーザービーム の透過率の低下をもたらすという欠点があった。

【0012】そこで、特開平4-21540号公報及び 特開平4-130031号公報に開示されるように、水 素過剰の酸水素火炎で合成した石英ガラスをさらに非酸 化性の雰囲気で熱処理することにより、吸収帯の生成を 防止することが開発された。

【0013】しかしながら、以上述べたような方法によ ってもロット間のばらつきがあり、非還元性の雰囲気下 での熱処理でも改質が不完全なこともあることがわかっ 20 る酸素分子の存在である。 た。

【0014】一方、合成石英ガラスの発光、吸収の理論 的説明は未だ十分にはなされていないが、合成石英ガラ スの欠陥構造に起因し、荷電粒子線、電子線、X線、γ 線、そして、高い光子エネルギーを有する紫外線などに\*

【化1】

 $30, -- \rightarrow 20$ 

【0019】この合成石英ガラスに水素熱処理を施す ٤,

 $\equiv S i - O - O - S i \equiv \stackrel{h}{-} \rightarrow \equiv S i - O - O \cdot + \equiv S i \cdot$ 

の反応によりパーオキシラジカルが発光中心となる。 【0018】一方、酸素分子が前駆体の場合は、酸素分 子がオゾンに変換され、発光中心(カラーセンター)に 30 なると考えられている。すなわち、以下の反応がおこな われている。

 $\equiv Si - O - O - Si \equiv +H_2 \rightarrow \equiv Si - OH HO - Si \equiv$ 

となり、あるいは、石英ガラス中の過剰の溶存酸素は水 素と結合して水となり発光中心が減少して発光は抑制さ れる。この反応を(2)式で示す。

 $O_2 + 2 H_2 \rightarrow 2 H_2 O$ (2)

【0020】しかし、この方法は、改質効果が継続的に 発揮できず、種々の影響因子によって改質効果が消滅す ることがある。例えば、前記の方法で合成石英ガラスを 40 大気中で熱処理すると、改質効果が消滅し、エキシマレ ーザーの照射や、スパッタリング、プラズマエッチング などを行うと、再び650nmの発光が発生するように なってしまう。

【0021】また、特開平2-64645号公報に開示 された方法によって製造された合成石英ガラスでは、再 熱処理をおこなっても、エキシマレーザー照射時の26 0 nmの吸収帯の生成および650 nmの赤色発光帯は 観測されない。しかし、さらに詳細に検討すると、この 方法によって製造した合成石英ガラスにArFエキシマ 50 ArFエキシマレーザーの照射およびKrFエキシマレ

\*よる一光子吸収あるいは多光子吸収によって、色中心が 生成されるためと考えられている。

【0015】石英ガラスの吸収、発光という分光学的性 質は、現在のところ、次のように説明される。

#### a)酸素過剰

合成石英ガラスの製造において、酸水素火炎の酸素が過 剰な場合、すなわち、H2/O2く2となるような時は、 エキシマレーザーなどの照射によって260nmの吸収 帯が生じ、それに伴って650nmの赤色発光帯が生成

#### b) 水素過剰

逆に酸水素火炎が水素過剰の場合(H2/O2>2)、合 成石英ガラス中に過剰の水素が残存し、220nmの吸 収帯の生成およびそれに伴う280nmの発光帯がみら

【0016】260nmの吸収帯の生成およびそれに伴 う650nmの赤色発光の原因として考えられること は、酸素過剰の条件下で石英ガラスを合成したことによ るパーオキシリンケージの存在と石英ガラス中に溶存す

【0017】パーオキシリンケージの存在の場合は、石 英ガラスに照射したX線や紫外線などの高い光子エネル ギーを有する電磁波によってパーオキシリンケージが発 光中心の前駆体となり、

※【化2】

(1)

レーザーを照射すると、280nmに強い発光帯が生 じ、220 nmに吸収帯が生成されることが判明した。 また、ArFエキシマレーザーを照射し220nm吸収 帯が生成するに伴ってArFエキシマレーザー自身の透 過率も低下する。

【0022】また、KrFエキシマレーザーを照射した 場合は、短時間の照射(略103ショット)では280 nmの発光帯、および220nmの吸収帯は生ぜず、K rFエキシマレーザー自身の透過率低下もみられない が、これを長時間にわたり照射(10%ショット以上) すると、ArFエキシマレーザー照射時と同様に280 nmの発光帯、および220nmの吸収帯が生じるよう になる。

【0023】このため、化学量論的必要量より水素過剰 で製造すると260nmの吸収帯の生成、及びそれに伴 う650nmの赤色発光防止のためには有効であるが、

ーザーの長時間照射には適さないことになる。

【0024】220nmの吸収帯は ≡Si・構造をも ったE'センターと呼ばれている欠陥構造が原因である ことが知られている(D. L. Griscom, セラミ ック協会学術論文誌、99巻923ページ参照)。

【0025】E'センターの前駆体としては、 ≡Si - H が考えられ、還元雰囲気下で合成した石英ガラス 中では、式(3)のような機構でE'センターが生成さ\* \*れ、さらに、熱処理によるE'センターの生成防止のメ カニズムとしては式4のようなメカニズムが提案されて いる (N. Kuzuu, Y. Komatsu and M. Murahara, Physical Rev iew B, Vol. 44 pp. 9265-927 0 参照)。

【化3】

$$= Si - H \quad H - O - Si = - \rightarrow = Si \cdot H - O - Si = + H$$
 (3)

【化4】

【0026】以上の機構により、≡Si-H H-O-Si≡ の構造が合成石英ガラスから除去され、E'セ ンターの生成が抑止されると考えられ、このことは、合 成石英ガラスのArFエキシマレーザーの照射による6 50 nmおよび280 nmにおける発光帯の生成及び2 60 nmと220 nmの吸収帯の生成を抑止した光学特 性を示す合成石英ガラスとして、特開平4-21540 号公報及び特開平4-130031号公報でその技術的 効果が明確にされた。

【0027】これは、石英ガラスの合成方法において、 溶存する酸素分子(O2)が1×1017個/cm3以下となる ようにこの合成石英ガラスを非還元性の雰囲気中、また は、真空中において、200~1200℃で熱処理する ものである。

【0028】しかしながら、以上述べたような方法によ ってもロット間のばらつきがあり、非還元性の雰囲気下 での熱処理でも、エキシマレーザーの長時間照射によ り、吸収帯が生成する場合があり、改質が不完全なこと もあることがわかった。そこで、本出願人は特開平6-※

$$\equiv Si - O - Si \equiv + H_2 - \rightarrow :$$

【0031】この構造を有する合成石英ガラスにエキシ マレーザーを照射すると、前記の式(3)の反応で、 E'センター(≡Si・)が生成される。この前駆体で ある≡Si-H H-O-Si≡構造を除去するために は、特開平4-21540号、特開平4-130031 号に示すごとく、適当な雰囲気中で熱処理することによ★

$$\equiv S i - O - S i \equiv - - \rightarrow S i \cdot \cdot \cdot O - S i \equiv$$
 (

【0032】このように、酸水素火炎を水素過剰として も石英ガラス中に ≡Si-H H-O-Si≡ 構造 を生成させないためには、歪んだ結合を少なくすること が有効で、これは、石英ガラス中のSi-OHの濃度を 高くすることによって達成できる。このように、Si-OHの濃度を高くすると、石英ガラスをある温度に保っ たとき準平衡に近づく時間を短縮でき、このため、石英 ガラス中のSi-〇-Si結合角の緩和が促進され、結 果として歪んだ結合の分布割合を少なくすることによ 50

※199531号公報に開示されるように、OH基の含有 量を1000ppmにすることにより、ArFエキシマ レーザー照射による吸収帯の生成を防止することを見い だした。

【0029】また、さらにOH含有量が高くなると、K r Fエキシマレーザー照射時に赤色発光が生ずることが 20 見出され、これを防止するため、OH基の含有量が10 00ppm以上の直接法合成石英ガラスを800℃以上 の温度で熱処理することにより、ArFエキシマレーザ 一照射時による吸収帯の生成を防止するとともに、Kr Fエキシマレーザー照射時の赤色発光を防止する方法を 開発した(特開平6-287022号公報)。

【0030】つまり、石英ガラス中にはSi-O-Si の結合角が平衡値(約143度)から大きくずれた結合 が多く存在しているため、合成時の酸水素火炎の水素の 量を化学量論的必要量よりも過剰にすると、水素分子が 30 石英ガラス網目中を拡散しうるため、これらの歪んだ結 合と水素が下記の式(5)で示す反応が進行し、≡Si -H H-O-Si≡の構造が生成される。

$$\equiv S i - O - S i \equiv + H_2 - - \rightarrow \equiv S i - H H - O - S i \equiv (5)$$

★り前駆体の除去が可能となる。ところが、もともとの石 英ガラスの結合構造が歪んでいるため、熱処理による前 駆体の除去は不完全であり、また、歪んだSi-O-S i 結合も式(6)に示すようにE'センターの前駆体と なる。

【化5】

り、熱処理においても周辺の構造の緩和も容易になり、 前駆体が除去される。

【0033】すなわち、石英ガラス中のOH基の濃度を 上げ、Si-OHの濃度を高くすることによって石英ガ ラス中のこの歪んだ結合の濃度が減少し、歪んだ構造に 基づくE'センターの生成が防止されるので、エキシマ レーザーに対する透過率の低下が生じない安定した光学 用合成石英ガラスを得ることができるのである。

[0034]

【発明が解決しょうとする課題】しかし、OH含有量を 高くすると、酸素が過剰の雰囲気で合成した場合ほど赤 色発光は強くないが、高いエネルギー密度のエキシマレ ーザーを照射すると赤色発光が生じ、安定してエキシマ レーザー用光学部材を得ることができない場合がある。 このことは、以下のように説明できる。

【0035】KrFおよびArFエキシマレーザーを照 射したときに生じる220nm吸収帯の強度のOH基濃 度依存性を調べたところ、OH基濃度が1000ppm のものに対して吸収帯が生成しないことがわかった。し 10 る確率が高くなる。そこで、ガラス製造時には、かなり かしながらOH基濃度が高くなると赤色発光が生じやす くなる。赤色発光の発生のメカニズムについては、前述 したとおり諸説がある(D. L. Griscom, セラ\*

$$\equiv S i - O - H \quad H - O - S i \equiv - - \rightarrow \equiv S i - O - O - S i \equiv + H_2$$
 (7)

【0037】ここでSi-O-O-Si構造はパーオキ シリンケージとよばれ、非架橋酸素説に基づくならば、 これから、エキシマレーザーの照射により式(8)のよ※ ※うな非架橋酸素が生じ赤色発光する。

進行するものと考えられる。

的に過剰な酸素が関係している。

【化6】

$$\equiv Si - O - O - Si \equiv -\frac{h\nu}{r} \rightarrow \equiv Si - O \cdot \cdot O - Si \equiv (8)$$

【0038】また、パーオキシリンケージからガラス生 20★成し、それが式9のように赤色発光の原因となること 成後冷却時に次のようなメカニズムにより溶存酸素が生★ も、考えられる。

$$\equiv S i - O - O - S i \equiv - - \rightarrow \equiv S i - O - S i \equiv + (1/2) O_2$$
 (9)

【0039】このほかに、Si-OH対から水素がと ☆られる。 れ、つぎの式10のように脱水縮合が生じることも考え☆

$$\equiv S i - O - H \quad H - O - S i \equiv - - \rightarrow \equiv S i - O - S i \equiv + H_2 O$$
 (10)

【0040】このとき、右辺のH2O分子は、ガラス網 目中を拡散しにくいため、その大部分はガラス網目構造 中に閉じこめられる。このようにして生成したH2O分 子も以下のようなメカニズムにより、赤色発光の前駆体 となりうる。 (N. Kuzuu, Y. Komatsu and M. murahara, PhysicalRe view, vol. B45, pp. 2050-2054◆

【0041】(10)式の反応によって生成したH2O の近傍にたまたまSi-OH基が存在すると、たがいに 水素結合によってくっつき、この水素結合した構造は電 30 子の非局在化によって、下記式11の構造の組み替えが 起こる。

\*ミックス協会学術論文誌、99巻, p. 923参照)。

すなわち、非架橋酸素欠陥 (≡Si-O・) によるも

の、ガラス中に溶損した酸素によるものなどの説がある

が、何れの説においても、ガラス中に存在する化学最論

【0036】また、OH濃度と赤色発光強度の関係は、

次のようなメカニズムによるものと考えることにより説

H-O-Si≡ のように Si-OH 構造が対にな

の時間高温にさらされているため、式7のような反応が

明される。OH基濃度が高くなると ISI-O-H

【化7】

**♦** (1992)).

$$\equiv S \stackrel{\cdot}{i} - O - H \qquad \longrightarrow \qquad \equiv S \stackrel{\cdot}{i} - O \cdots H \qquad \longrightarrow \qquad \equiv S \stackrel{\cdot}{i} - H + H_2 + O_2$$

$$\stackrel{\cdot}{H} - O \qquad \qquad H \qquad \qquad H$$

(11)

ここで、……は水素結合をあらわす。H2はガラス網目 中を拡散できるが、O2は拡散しにくいため取り残さ れ、この残存O2分子が赤色発光の前駆体となる。

【0042】ここで、水素拡散後、O2分子とともに≡ Si-H構造が残存する。これは、(3)式に示すよう\*

$$\equiv Si \cdot +O \longrightarrow \equiv Si -O \cdot$$

【0043】しかし、酸素過剰の雰囲気で合成し赤色発 光がきわめて強い石英ガラスにおいては、溶存オゾン分 子により260nmに吸収帯が生成し、同時に=Si-〇・によるきわめて弱い吸収帯が625nm付近に観測 される (N. Kuzuu, Y. Komatsu and M. murahara, Physical Revi

\*に、E'中心の前駆体となりうる。しかしながら、エキ シマレーザー照射時には、O2分子も光分解するため、 40 次の式12のような非架橋酸素欠陥ができ、このため、 220 nmの吸収帯は生成しなくなる。

(12)

992)).

【0044】これに対して、これを水素過剰の雰囲気下 で合成した場合、赤色発光が観測されても、比較的弱 く、260 nmおよび625 nmの吸収帯は観測されな い。OH基濃度と赤色発光の関係はいずれにしても、赤 色発光が生じるためには、ガラス生成過程でSi-OH ew, vol. B45, pp. 2050-2054 (1 50 対からの水素の脱離が関係しており、このため、赤色発

光を防止するために、水素中で熱処理することにより再び生成した前駆体を安定化することが有効となる。

【0045】本出願人は、四塩化珪素を化学量論的比率の酸水素火炎中で加水分解して得られた合成石英ガラスを水素ガス雰囲気中で熱処理することによっても赤色発光のない合成石英ガラスに改質することを特開平1-201664号ですでに開示した。しかし、水素熱処理したガラスを大気中でアニールすると再び赤色発光が生じる。これは、これらの対象とする石英ガラスがもともと酸素過剰の雰囲気下で合成され、大過剰の酸素分子が溶 10 担していると考えられるからである。このため、水素熱処理を行うとガラス中に多量のH2O分子が生成し、これをアニールすると再び酸素が生成するものと考えられる。

【0046】さらに、石英ガラスを水素過剰の条件下で合成したものを用いれば、赤色発光強度は酸素過剰の条件下で合成した石英ガラスに較べて格段に弱くなり、260nmの吸収帯も観測されなくなる。それをさらに水素ガス雰囲気中で熱処理すれば、赤色発光は発生しなくなる(特開平6-287022号)が、このとき、水素20処理により(4)式の逆反応が生じることも懸念されるが、ガラス網目構造中に存在している水素は、Si-O-Siの結合角が平衡値(143°)から大きくずれたものとのみ反応し、熱効果によりも逆に(4)式の反応が進行し、220nmの吸収帯の生成を防止するとともに赤色発光が抑止される。このとき、水素処理の条件は、800℃以上が好ましいが、900℃以上になると短時間処理も可能になる。

【0047】以上のように、ArFエキシマレーザー照射したときは、吸収帯の生成しない材料が得られるが、その後長時間の照射では、1000ppm以上では吸収帯が生成し、さらに赤色発光が発生することがあり、長時間光学材料としての使用したばあいの耐久性に問題があることがわかった。

【0048】本発明は、先の特願平6-199531号が、ArFエキシマレーザーにおいては、短時間照射(略10<sup>4</sup>ショット)を対象としているのに対して、さらに高パレス数(10<sup>6</sup>ショット以上)のエキシマレーザー照射や、誘電体バリア放電エキシマランプのように連続的に長時間(連続数百時間)にわたり照射しても、吸収帯の生成のない安定した光学用合成石英ガラス及び吸収帯の生成を防止する方法を提供することを目的とする。

### [0049]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 上記課題を解決するため、鋭意研究を重ねた結果、四塩 化珪素を酸水素火炎中で加水分解することにより、直接 堆積ガラス化してなる合成石英ガラスにおいて、合成時 の酸水素火炎の水素過剰雰囲気下の条件を特定し、水素 と酸素の比をモル比で2.2以上に設定し、かつ、合成 50 ガラス中の〇H含有量を1150ppm以上にすれば、 前記課題を解決できる光学用合成石英ガラスが得られる との知見を得て本発明を完成した。

10

[0050]

【作用】四塩化珪素を酸水素火炎中で加水分解する石英ガラスの合成方法において、水素と酸素の比をモル比で>2とし、かつ〇H含有量を1000ppm以上にすると、ボンドの解裂による220nm吸収帯の生成が少なくなることを見出した。

【0051】しかしながら、OH基を多くすることにより、赤色発光が生成し、これを水素中で800℃以上の温度で熱処理することにより、赤色発光は防止できるが、長時間の照射を繰り返すと、220nmの吸収が生じるばかりでなく、赤色発光も再び生じることが知見された。これは、長時間の照射に伴い、(6)式の反応が進行し、 $\equiv$ Si・により、220nmの吸収帯が生成し、 $\equiv$ Si・により赤色発光が生じるためと考えられる。また、水素処理によって、 $H_2$ Oとなって安定化した溶存酸素が長時間照射の熱および光化学的変化によって(11)の反応が除々に進行し、溶存 $O_2$ および(11)式の右辺の $\equiv$ Si-Hが前駆体となってE'センターが生成するものと考えられる。

【0052】この(6)式の反応を防止するためには、さらに〇日含有量を増やしても歪んだボンドの量をさらに下げてやる必要がある。また、〇日量が多くなると赤色発光が生じやすくなる問題があったが、水素で処理したものは(5)式の反応により若干ではあるがE'センターの前駆体が生じる可能性がある。そこで〇日含有量を1150ppm以上に設定するとともに、合成時の日2/O2比を2.2以上に設定することによりエネルギー線長時間照射による220nm付近にピークをもつ吸収帯の生成を防止すると共に赤色発光をも防止することができた。

【0053】以上のような条件で製造した石英ガラスは200~1200℃位の温度範囲での還元性雰囲気、非還元性雰囲気または不活性雰囲気や真空中といった各種雰囲気下での熱処理に対して安定である。つまり、特開平4-21540号に開示されているように、熱処理することにより吸収帯の生成防止効果があることが知られているが、本発明における石英ガラスは、OH含有量を1150ppm以上に設定し、かつ合成時の火炎の水素/酸素の比率をモル比で2.2以上に設定したため、すでに吸収帯の生成が防止され、これを還元性雰囲気、非還元性雰囲気または不活性ガス雰囲気や真空中で200~1200℃で熱処理してももはや吸収帯は生成しない。従って、吸収帯生成防止のための熱処理はなんら必要なく、該石英ガラスを除歪や均質化の目的で熱処理することもできる。

[0054]

【効果】合成時の水素/酸素比をモル比で2.2以上に

設定し、さらにOH含有量が1150ppm以上のもの を使用することにより、KrF及びArFエキシマレー ザーを長時間照射しても、石英ガラスに吸収帯の生成が なく安定した光学用合成石英ガラスとなり、連続的に長 時間にわたり照射を受ける誘電体バリア放電エキシマラ ンプ等に有効に利用することができる。

【0055】また、石英ガラス中のOH基濃度を115 0 p p m以上とし、かつ、酸・水素火炎の水素と酸素の 比がモル比で2. 2よりも過剰の水素の存在下で合成す ることによって、電磁波、ArF、KrFエキシマレー 10 ザーまたはKrCl、Xe2等のエキシマランプの紫外 線等のエネルギー線の長時間照射で、E'センターによ る220nm付近及び260nm付近にピークをもつ吸 収帯の生成を防止する方法としても用いることができ

[0056] 【実施例】 実施例1

\*直接堆積ガラス化法において、四塩化珪素を水素と酸素 の割合を表1に示す化学量論的必要量より過剰水素のモ ル比の酸水素火炎で加水分解し、かつ石英ガラスの合成 時に不活性ガスを含むパーナーの反応条件および排ガス の排気条件を調整することによってOH濃度を調整し、 石英ガラスA~Mを合成した。得られた合成石英ガラス の試料A~Mから略10mm×10mm×30mmの試 料片を切り出した。

12

【0057】次いで、このそれぞれの試料にArFエキ シマレーザー100mJ/cm<sup>2</sup>、100Hzを照射し、 照射前および10⁴, 10⁵, 106ショット照射後の吸 収を測定し、220nmにおける内部吸収係数を求め表 1に示した。またこれとは別に実施例1で得た試料片A ~Mに、KrFエキシマレーザー, 25Hzを1.5分 間照射したときの赤色発光が認められる最低のエネルギ 一密度を測定した。その結果を表1に示す。

[0058]

【表1】

- AX 1								
試料	0	H	H./O.	ArF誘	起吸収(10-	a cm-1)	KrF誘起赤色発光	
	p	рп		10~ショット	105ショット	10°ショット	(J/cm²)	
Α	6	8 0	2. 3	1. 5	2. 5	4.0	0.50	
В	1 0	4 0	2. 3	n.d.	2. 0	3. 2	0,40	
С	1 1	0.0	2. 3	n.d.	0.6	1. 1	0.30	
D	1 1	5 0	2. 3	n. d.	n. d.	n. d.	0.30	
Е	1 1	3 0	2.3	n. d.	n.d.	n. d.	0.30	
F	1 3	0 0	2.3	n.d.	n.d.	n. d.	0.20	
G	1 4	5 0	2. 3	n. d.	n. d.	n. d.	0.20	
Н	1 0	00	2. 1	2. 2	2.4	3. 5	0.20	
I	10	8 0	2. 1	n. d.	1. 5	2. 5	0.15	
J	1 1	6 0	2. 1	n. d.	n. d.	n. d.	0.15	
к	1 2	1 0	2. 1	n. d.	n.d.	n. d.	0, 10	
L	1 3	0 0	2. 1	n.d.	n. d.	n. d.	0.05	
М	1 4	0.0	2. 1	n. d.	n. d.	n. d.	0.05	

これにより、水素と酸素の比をモル比で2. 2以上に設 定し、合成ガラス中のOH含有量を1150ppm以上 にしたD~Gが、220nmにおける吸収もなく、か つ、赤色発光が生ずる最低エネルギー密度も200mJ /cm<sup>2</sup>以上であり、260nmの吸収も生成しないこ とから高いエネルギーに用いることができることが判

#### 【0059】実施例2

実施例1に準じて、水素と酸素の割合を $H_2/O_2=2$ . 3で合成し、OH基を1300ppm含有する試料X と、水素と酸素の割合を $H_2/O_2=2$ . 1で合成し、O H基を1020ppm含有する試料Yを得て、これを2

磨したのち、エキシマレーザーの光路にビームと45° の角度をなすようにセットし、エキシマレーザーのパワ 40 一をモニターするビームスプリッタとして使用した。通 常の検査のように、ArF、100mJ/cm<sup>2</sup>、10 OHzでの発振と、KrF100mJ/cm²,25Hz での発振とほぼ同パルス発振するような条件下で運転 し、レーザーのパルスカウンターが10%ショットとな った時点で取り外し、エキシマレーザーピームが照射さ れた部分と照射の差スペクトルを測定した。

【0060】この結果、ArF100mJ/cm2、10 OHzで同ピームスプリッタを10<sup>4</sup>、10<sup>5</sup>、10<sup>6</sup>、 10<sup>7</sup>ショット照射時には、試料X、Yとも透過率の低  $5\,\mathrm{mm} imes 5\,0\,\mathrm{mm} imes 1\,t$  の形状に加工し、表面を光学研 50 下は測定限界以下であったが、 $1\,0^8\,$ ショットでは、試 7.5

料Yでは220nmをピークとする吸収帯が生成し、2 20nmにおいて透過率が10%低下していた。また、 エキシマレーザー照射時に発光を観察したところ赤色発 光が認められた。これに対して、試料Xでは、透過率低下が2%程度で、はっきりした発光は認められなかった。

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-295520

(43)Date of publication of application: 12.11.1996

(51)Int.CI.

CO3B 8/04

CO3B 20/00 CO3C 3/06

H01S 3/08

(21)Application number: 07-123085

(71)Applicant: NIPPON SEKIEI GLASS KK

(22)Date of filing:

24.04.1995

(72)Inventor: KUZUU SHIN

## (54) SYNTHETIC QUARTZ GLASS FOR OPTICAL USE AND PREVENTING METHOD OF FORMATION OF ABSORPTION ZONE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To produce a stable synthetic quartz glass for optical use free from the formation of absorption zone even after irradiation with excimer laser having high pulse numbers (≥106 shot) or continuous and long term (continuously several hundred hours) irradiation with such a dielectric discharge excimer laser lamp and to prevent the formation of absorption zone. CONSTITUTION: In the synthetic quartz glass obtained by hydrolyzing silicon tetrachloride in oxyhydrogen flame to directly deposit and vitrify, this synthetic quartz glass for optical use in synthesized under a condition of ≥2.2 in the molar ratio of hydrogen to oxygen in the oxyhydrogen flame, and contains ≥1150ppm OH group and is prevented from the formation of absorption zone caused by the long term irradiation with energy rays.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

08.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office